

WS488 SOLDADURA EN PASTA SOLUBLE EN AGUA

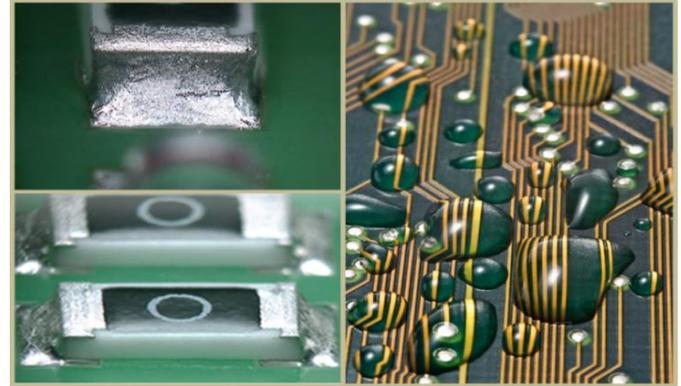
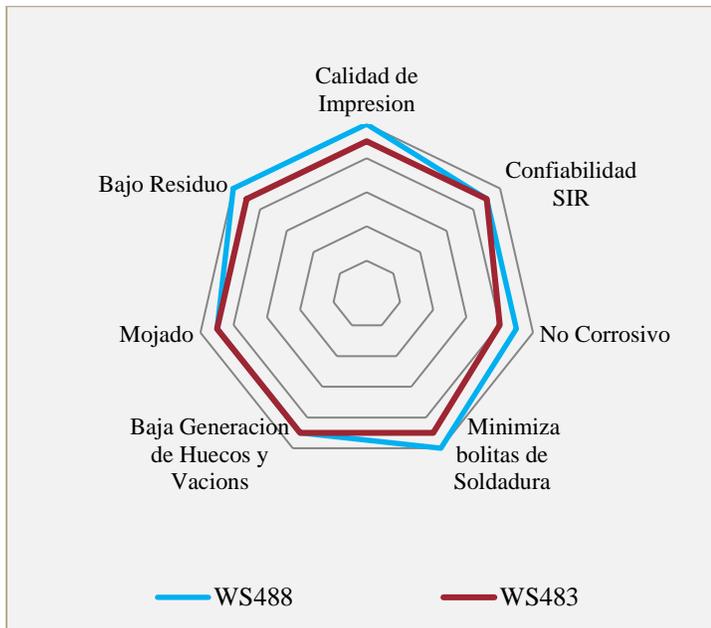
CARACTERÍSTICAS

- Excelente Acción Humectante y Mojado de Soldadura.
- Amplio rango de Limpieza.
- Excelentes Características de Impresión.
- Vida en el Esténcil > 8 Horas.
- Fácil Remoción Con Agua.
- Baja Generación de Espuma

DESCRIPCIÓN

La fórmula de la soldadura en pasta soluble en agua WS488 de AIM ofrece una potente acción de mojado sobre cualquier tipo de superficie y acabado de tarjetas electrónicas, en componentes, ensamblajes y sustratos. Tiene una amplia tolerancia a las condiciones ambientales y excelentes características de impresión, ofreciendo más de 8 horas de vida sobre el esténcil. WS488 ha sido desarrollado para proporcionar un rendimiento estable en aleaciones con plomo y libres de plomo. Los residuos de la soldadura en pasta WS488 son altamente solubles y se eliminan fácilmente en agua. Este producto multipropósito se ha creado para satisfacer la demanda de la industria para procesos que requieren soldadura soluble en agua consistente y confiable.

CARACTERÍSTICAS



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	6 meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	2 semanas	< 25°C (< 77°F)

No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de WS488 para información específica del producto.

LIMPIEZA

Antes del Reflujo: Se recomienda el uso del limpiador AIM DJAW-10 que remueve eficazmente los residuos de soldadura en pasta WS488 de la superficie de estenciles y aperturas. Puede ser aplicado a mano o con el sistema automático de limpieza del equipo de impresión de pasta. No se recomienda aplicar en exceso o directamente al esténcil por la parte superior, no mezclar DJAW-10 con Alcohol Isopropilico (IPA) o cualquier otro solvente. Alcohol Isopropilico (IPA) puede ser utilizado al final del proceso de limpieza del esténcil con DJAW-10 solo como enjuague.

Después del Reflujo: Los residuos de la soldadura en pasta WS488 pueden permanecer en el ensamblaje después del reflujo por un periodo de hasta 2 semanas sin corrosión. La limpieza es obligatoria y puede realizarse usando agua a una temperatura 50°C-60°C (120°F-140°F) seguida de un enjuague final con agua desionizada.

PERFIL DE REFLUJO

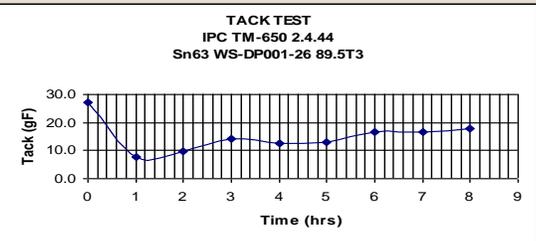
Toda la información del perfil se puede encontrar en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Póngase en contacto con AIM para obtener información adicional y/o soporte para su proceso.

IMPRESIÓN

Configuración Inicial Recomendada - Varía de acuerdo al tipo y diseño del PCB o pad	
Parámetro	Valor Inicial Recomendado
Presión de las Navajas	0.10-0.30 kg/cm (.6 - 1.7 lbs/In.) de Navaja
Velocidad de las Navajas	12-150 mm/sec (.5-6"/seg)
Distancia de Separación (Snap-off)	En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y estencil	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y estencil	Lento

DATOS DE PRUEBAS

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Clasificación de IPC	J-STD-004 3.2.3.1	ORM1	
Clasificación de IPC	J-STD-004B 3.3.1.2.1	ORM1	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	M = < 50% de Penetracion	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente.	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	Menor	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antes</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Después</p>  </div> </div>
Contenido de Haluro(s) por Método de Cromatografía Iónica	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	0.07% Tipico	M1
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	Haluros Presentes	

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen																				
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros																					
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	Despues de Limpieza.																				
Índice de Acidez del Fundente	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	55.2 mg KOH/g Flux Tipico																					
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	600-1000 Kcps Tipico																					
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Café Oscuro																					
Prueba colapsamiento de la Soldadura en Pasta (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASS																					
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASS																					
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	30.5 gf Tipico	 <p>TACK TEST IPC TM-650 2.4.44 Sn63 WS-DP001-26 89.5T3</p> <table border="1"> <caption>Tack Test Data</caption> <thead> <tr> <th>Time (hrs)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>30.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>10</td></tr> <tr><td>2</td><td>12</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td></tr> <tr><td>4</td><td>12</td></tr> <tr><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>6</td><td>18</td></tr> <tr><td>7</td><td>17</td></tr> <tr><td>8</td><td>19</td></tr> </tbody> </table>	Time (hrs)	Tack (gf)	0	30.5	1	10	2	12	3	15	4	12	5	13	6	18	7	17	8	19
Time (hrs)	Tack (gf)																						
0	30.5																						
1	10																						
2	12																						
3	15																						
4	12																						
5	13																						
6	18																						
7	17																						
8	19																						
Prueba de Mojado (Wetting)	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASS																					

*Con el fin de tener una calificación ORL0, la pasta de soldadura tiene que pasar SIR sin limpiar. Como WS488 es una química de pasta soluble en agua que requiere una limpieza, que tiene una clasificación de ORM1 para los estándares IPC.